



ファインテクノロジーで未来を拓く

NaigaiTEC 内外テック株式会社

JASDAQ・コード3374

平成18年3月期 決算説明会

平成18年5月30日

代表取締役社長 権田浩一

平成18年3月期の概況

1. 連結 平成18年3月期の概況

(単位:百万円)

連結損益	17/3期 (実績)	18/3期(実績)			前期比	18/3期 予想	予想比	コメント
		上期	下期	通期				
売上高	19,746	8,396	9,881	18,278	△7.4%	17,143	6.6%	第3Qより受注拡大、第4Qより売上の急激な回復
販売事業	17,288	7,232	8,393	15,626	△9.6%	14,611	6.9%	
受託製造事業	2,458	1,163	1,488	2,652	7.9%	2,532	4.7%	受託製造事業、前期比増+194
売上原価	17,716	7,585	8,786	16,372	△7.6%	15,261	7.3%	
売上総利益	2,030	811	1,094	1,905	△6.2%	1,882	1.2%	棚卸資産評価減△60
販売費及び一般管理費	1,427	784	759	1,543	8.1%	1,540	0.2%	業務委託原価の振替+64
営業利益	602	26	335	361	△40.0%	341	5.9%	
経常利益	536	△27	314	287	△46.5%	257	11.7%	公開費用(新株発行費含)△29
特別損益	4	△70	60	△9	—	△70	—	減損損失△70、固定資産売却益+12、投資有価証券売却益+47
当期純利益	275	△65	220	154	△44.0%	107	43.9%	

(注)18/3期予想は、11月18日付の「業績予想の修正に関するお知らせ」にて発表した予想であります。

2. 個別 平成18年3月期の概況

(単位:百万円)

個別損益	17/3期 (実績)	18/3期(実績)			前期比	18/3期 予想	予想比	コメント
		上期	下期	通期				
売上高	17,980	7,576	8,887	16,463	△8.4%	15,518	6.1%	第3Qより受注拡大、第4Qより売上の急激な回復
売上原価	16,122	6,858	7,949	14,808	△8.2%	13,894	6.6%	
売上総利益	1,857	717	937	1,655	△10.9%	1,623	2.0%	コストダウン圧力吸収できず、利益率0.27ポイント低下
販売費及び一般管理費	1,395	721	705	1,426	2.2%	1,417	0.6%	下期販売管理費圧縮
営業利益	462	△3	232	228	△50.6%	206	10.7%	
経常利益	459	△25	237	211	△54.0%	182	15.9%	公開費用(新株発行費含)△29
特別損益	4	△66	61	△4	—	△65	—	減損損失△65、固定資産売却益+12、投資有価証券売却益+47
当期純利益	234	△58	173	115	△50.9%	60	91.7%	

(注)18/3期予想は、11月18日付の「業績予想の修正に関するお知らせ」にて発表した予想であります。

3. 連結 財務分析(貸借対照表)

(単位:百万円)

連結貸借対照表	17/3期 (実績)	18/3期 (実績)	前期比	コメント
流動資産合計	8,661	9,119	457	受取手形及び売掛金 + 570 棚卸資産△89
固定資産合計	3,449	3,241	△ 207	減損会計による評価及び固定資産の 売却△335、投資有価証券 + 195 差入保証金 + 31
資産合計	12,110	12,360	249	
負債合計	10,418	10,109	△ 309	支払手形及び買掛金 + 324 有利子負債△553 未払税金等△58
資本合計	1,692	2,251	559	増資 + 308 有価証券評価差額 + 118
負債及び資本合計	12,110	12,360	249	

4. 個別 財務分析(貸借対照表)

(単位:百万円)

個別貸借対照表	17/3期 (実績)	18/3期 (実績)	前期比	コメント
流動資産合計	7,898	8,371	472	受取手形及び売掛金 + 587 棚卸資産△137
固定資産合計	2,236	2,064	△ 171	減損会計による評価及び固定資産の 売却△298、投資有価証券 + 195 差入保証金 + 31
資産合計	10,135	10,435	300	
負債合計	8,676	8,457	△ 219	支払手形及び買掛金 + 293 有利子負債△395 未払税金等△99
資本合計	1,458	1,978	519	増資 + 308 有価証券評価差額 + 118
負債及び資本合計	10,135	10,435	300	

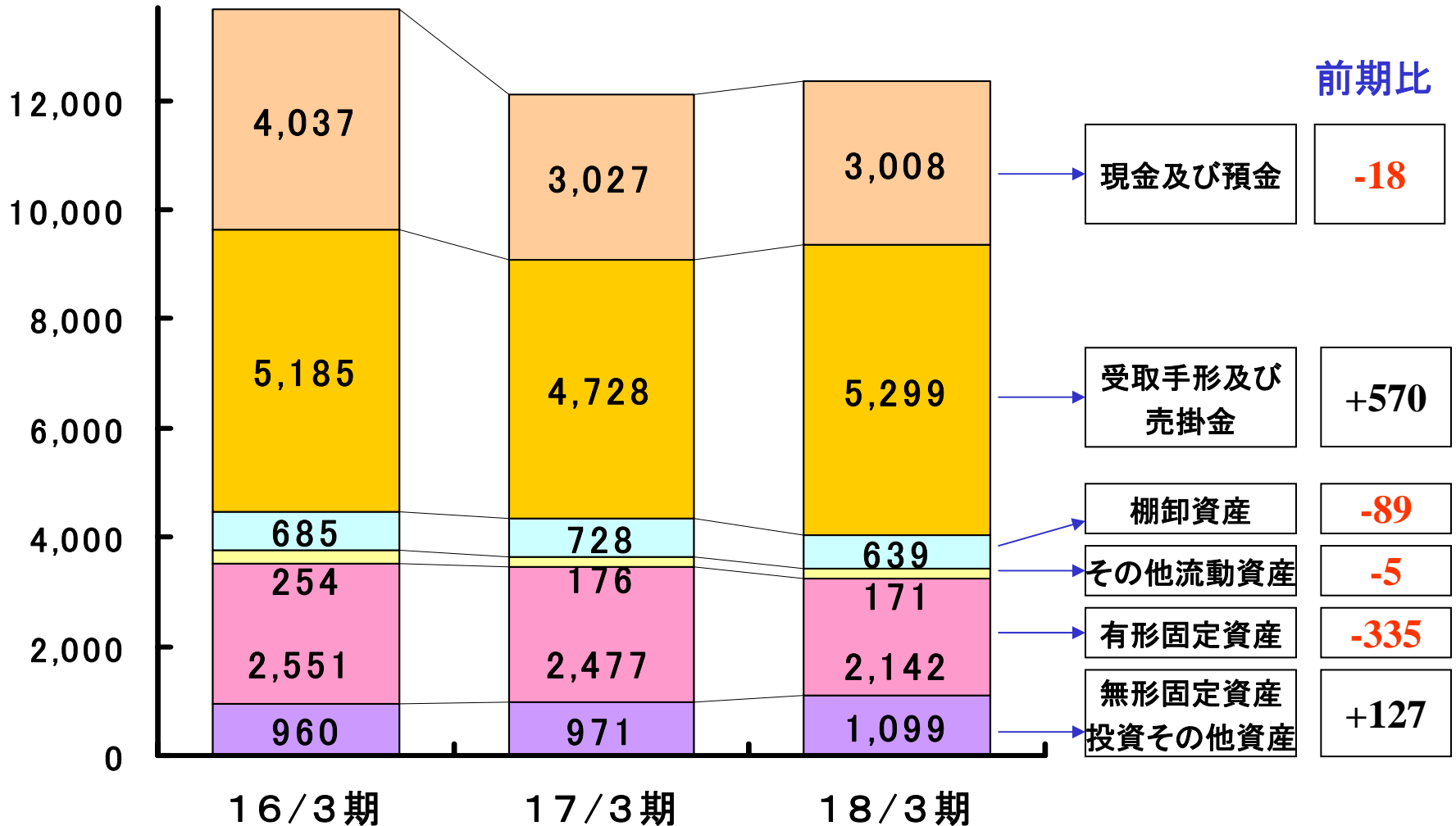
5. 連結 財務分析(キャッシュフロー)

(単位:百万円)

連結キャッシュフロー	17/3期 (実績)	18/3期 (実績)	コメント
営業活動によるCF	△ 474	17	減価償却費+84、減損損失+70 売上増加△573、仕入増加+336 法人税等の支払額△150、在庫抑制+86
投資活動によるCF	50	268	固定資産売却+223 投資有価証券売却+64
財務活動によるCF	△ 540	△ 267	株式発行増加+308、短期借入金減少△50 長期借入金減少△303 社債償還減少△200
現金及び現金同等物の増減額	△ 963	18	
現金及び現金同等物の期末残高	2,807	2,825	

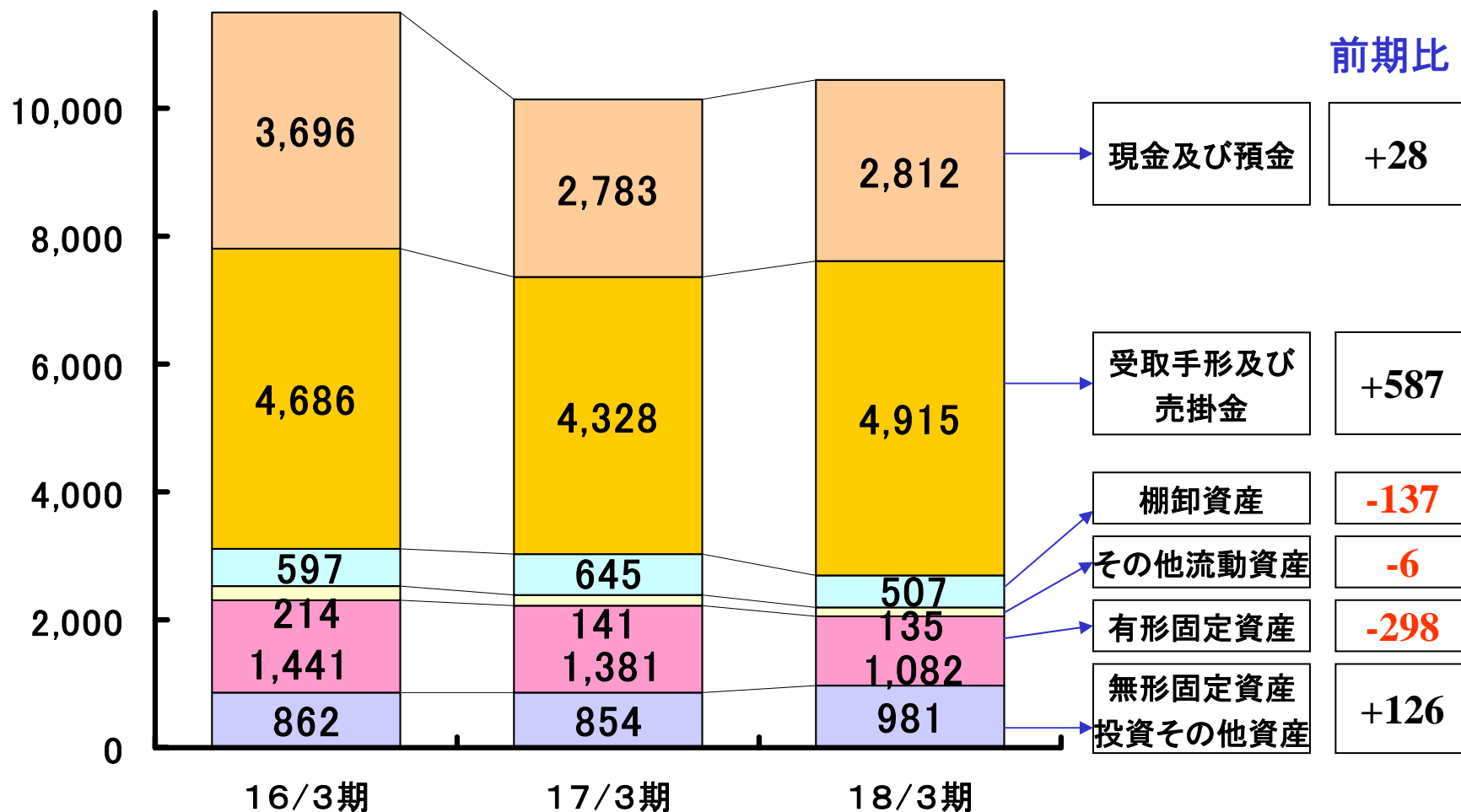
6. 連結 資産の部推移

(単位:百万円)



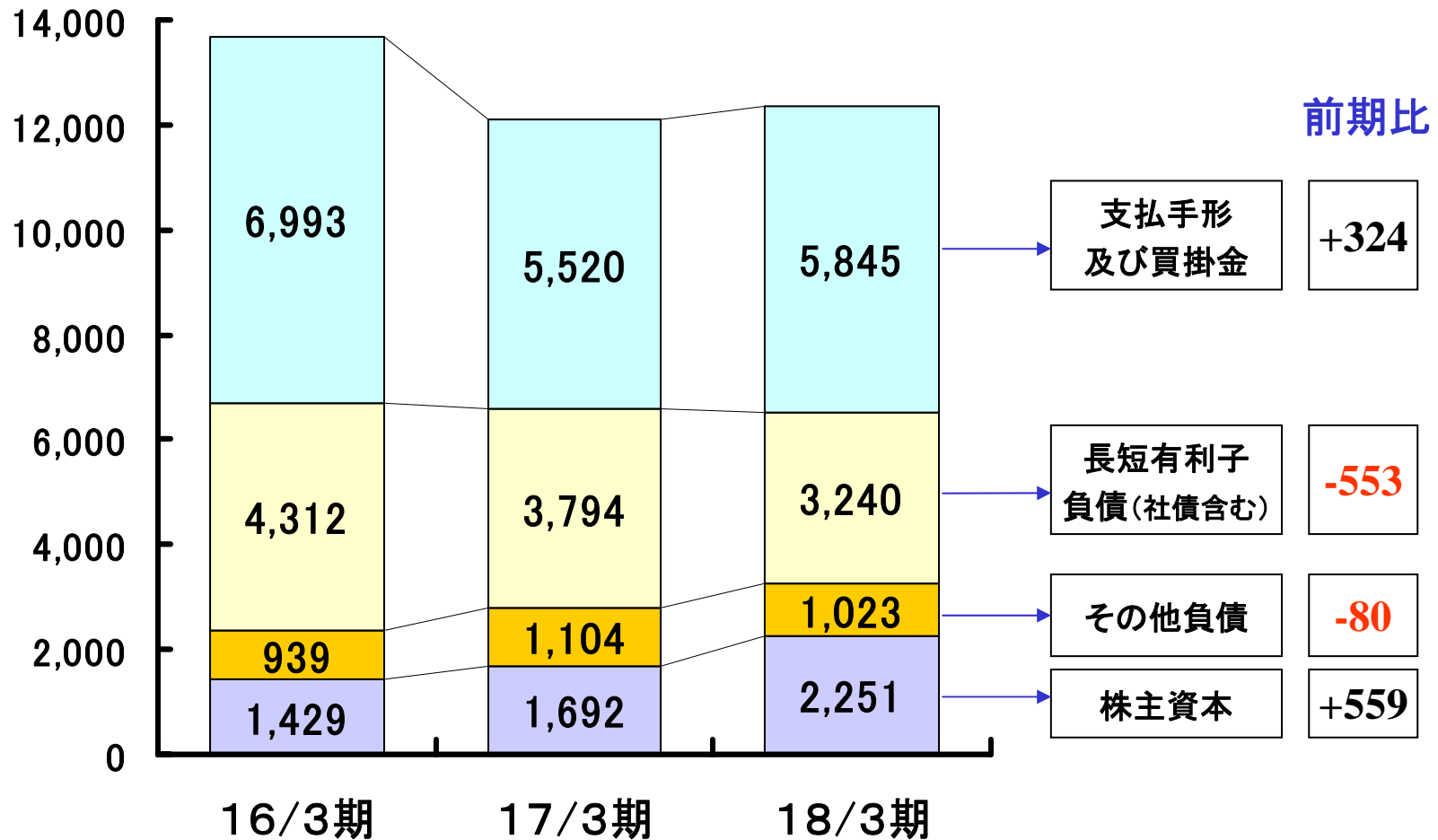
7. 個別 資産の部推移

(単位:百万円)

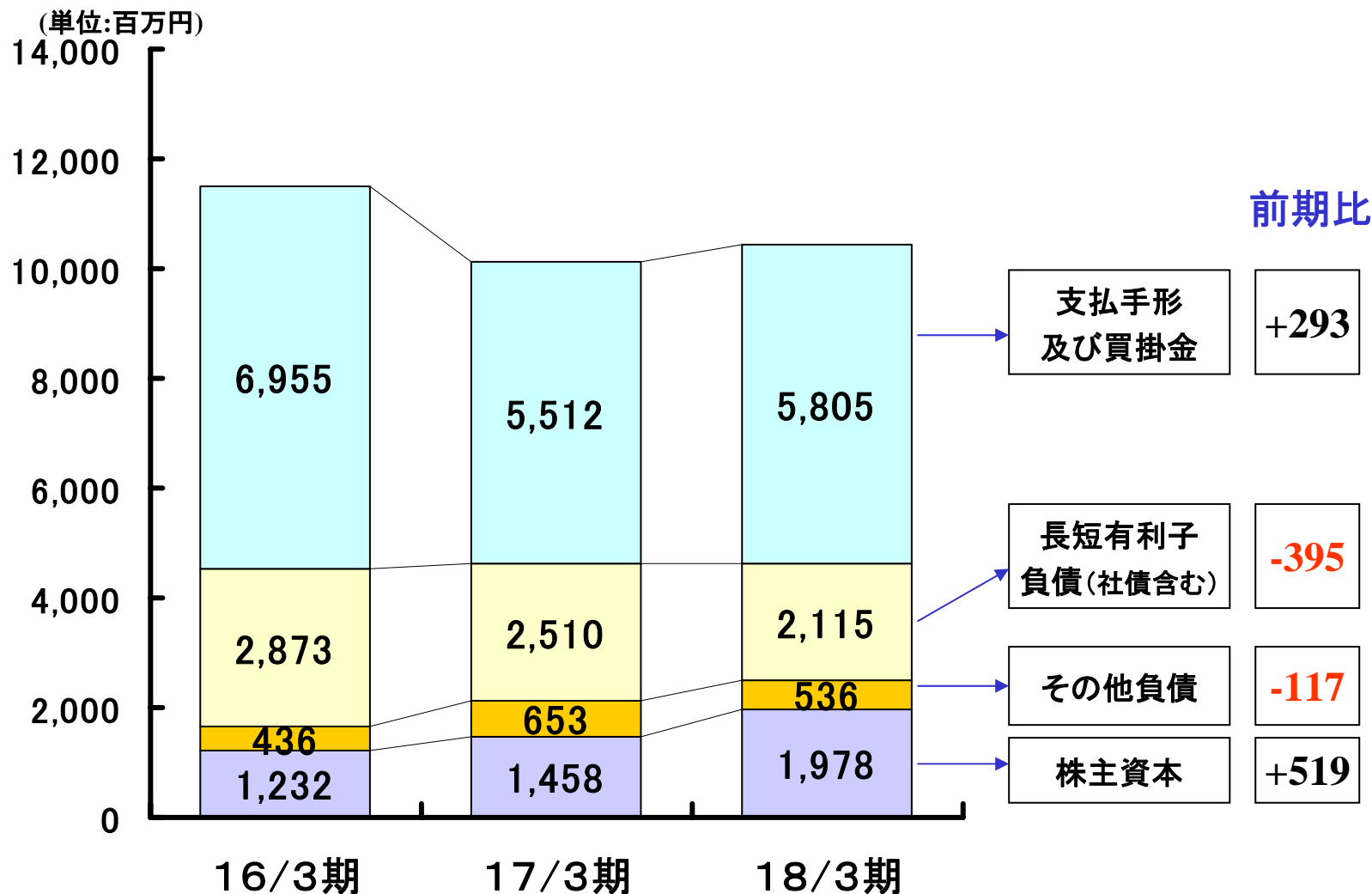


8. 連結 負債・資本の部推移

(単位:百万円)



9. 個別 負債・資本の部推移

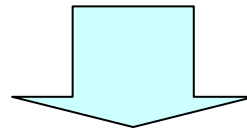


平成19年3月期の予想

10. 平成19年3月期の見通し

全体の市場動向からは2007/3期、2008/3期は拡大局面

- ・ 主要ユーザーが軒並み、高成長を予測
- ・ 主要仕入先についても、半導体分野における回復成長を予測
- ・ 2006年(ワールドカップ)、2008年(北京オリンピック)のイベント効果
- ・ 半導体・半導体製造装置・FPDの成長が一致



売上は市場の成長により拡大 …… コストダウン圧力により収益圧迫
いかに受託製造分野が伸ばせるか

11. 連結 平成19年3月期の見通し

(単位:百万円)

連結損益	18/3期 (実績)	19/3期予想			前期比	コメント
		上期	下期	通期		
売上高	18,278	10,090	10,126	20,216	10.6%	受託製造事業を中心に売上増
販売事業	15,626	8,458	8,164	16,622	6.4%	
受託製造事業	2,652	1,631	1,962	3,594	35.5%	前期比 +941 内外テクノシステムズの設立
売上原価	16,372	9,038	8,965	18,003	10.0%	物流コストの改善
売上総利益	1,905	1,051	1,161	2,213	16.2%	売上増加による増加
販売費及び一般管理費	1,543	844	841	1,686	9.3%	新規子会社による管理コストの増加
営業利益	361	207	319	526	45.7%	
経常利益	287	168	278	446	55.4%	
当期純利益	154	84	161	246	59.7%	
1株当たり利益(円)	31.21	—	—	48.53	55.5%	

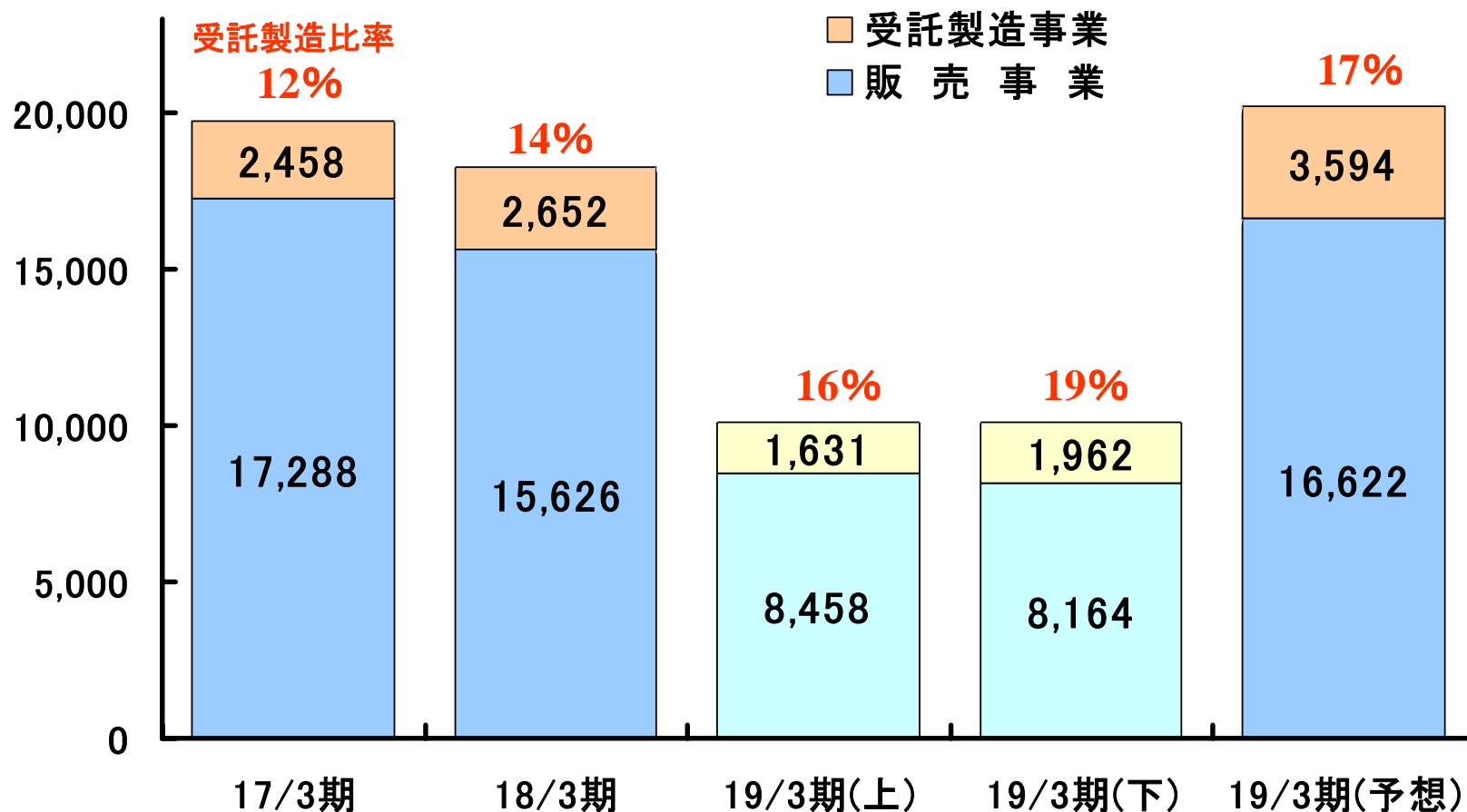
12. 個別 平成19年3月期の見通し

(単位:百万円)

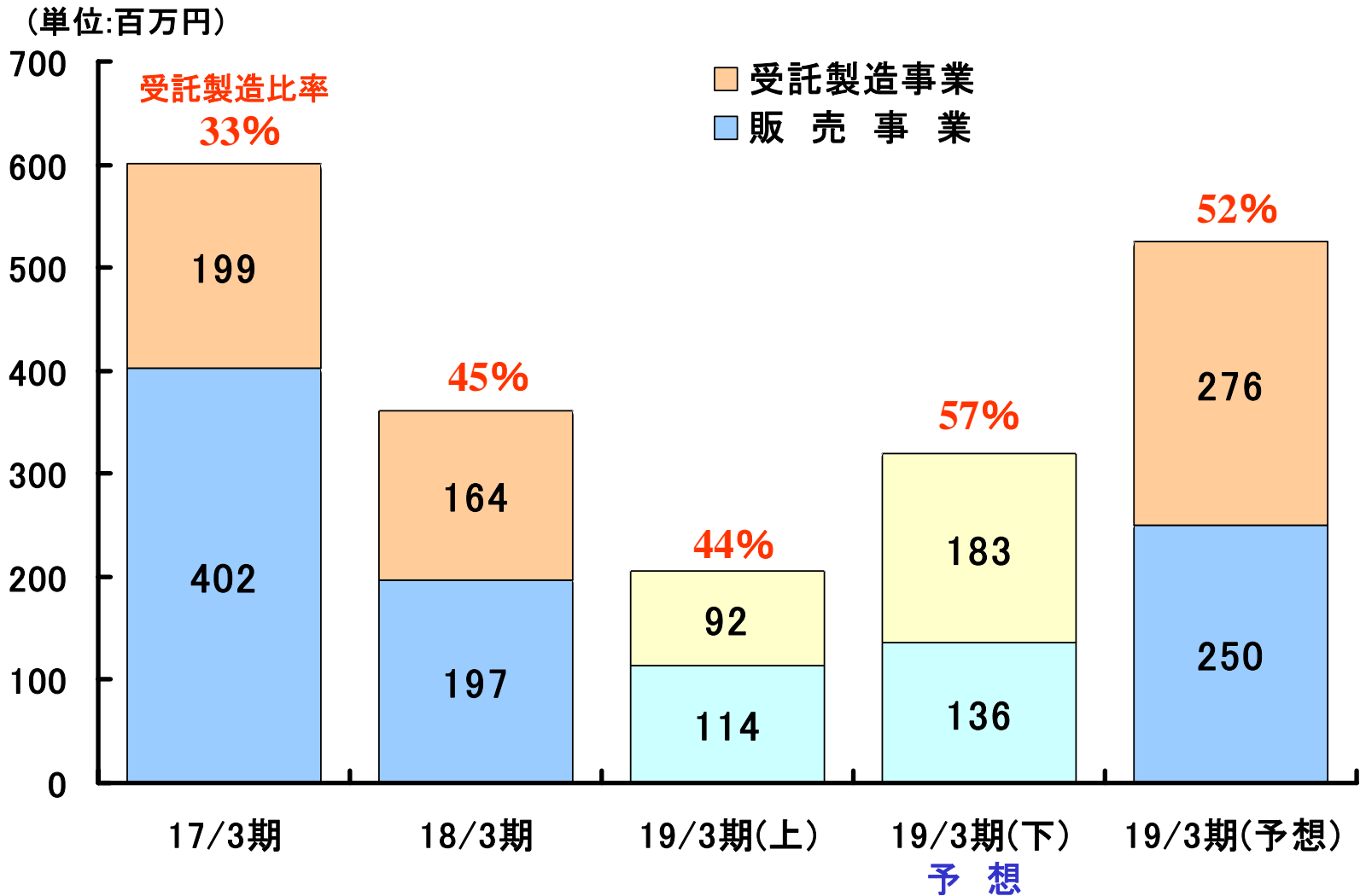
個別損益	18/3期 (実績)	19/3期予想			前期比	コメント
		上期	下期	通期		
売上高	16,463	9,097	8,984	18,082	9.8%	主要顧客の増産計画、旺盛な設備投資計画
売上原価	14,808	8,215	8,096	16,311	10.1%	
売上総利益	1,655	882	888	1,770	6.9%	コストダウン圧力の不透明感・保守ビジネスの子会社移管
販売費及び一般管理費	1,426	735	715	1,450	1.7%	
営業利益	228	146	173	320	40.4%	
経常利益	211	146	164	310	46.9%	
当期純利益	115	83	93	177	53.9%	
1株当たり利益(円)	23.26	—	—	34.93	50.2%	

13. 連結 セグメント別売上推移

(単位:百万円)

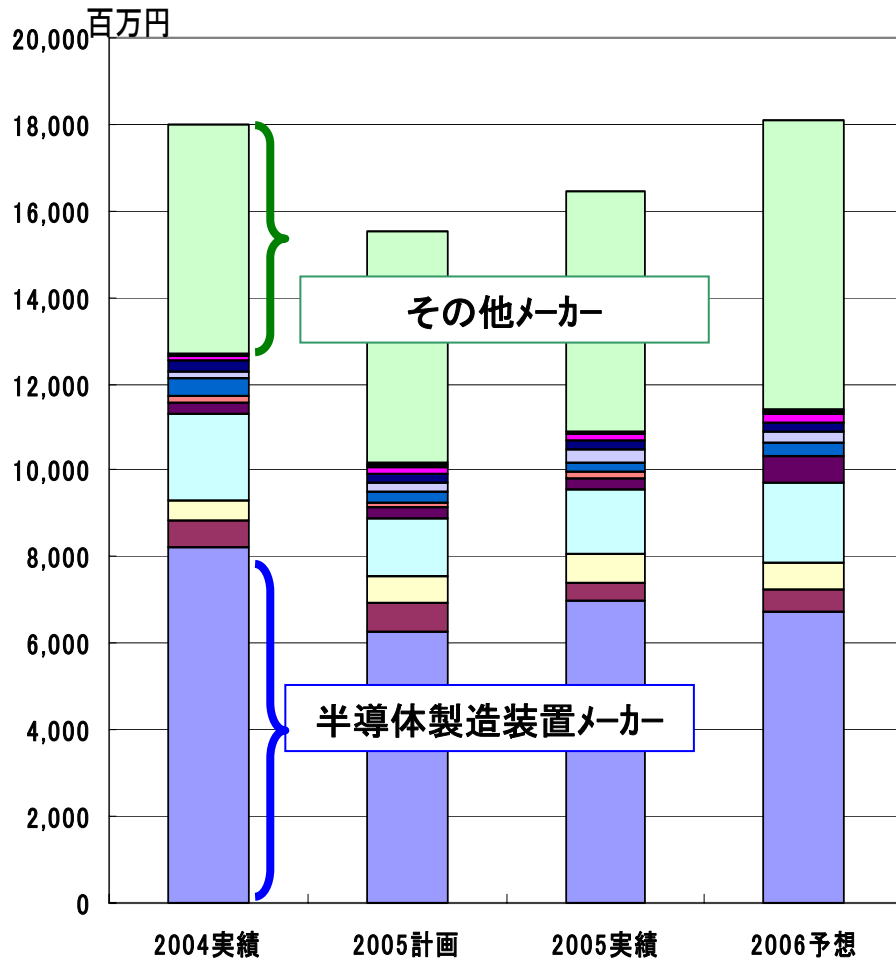


14. 連結 セグメント別営業利益推移

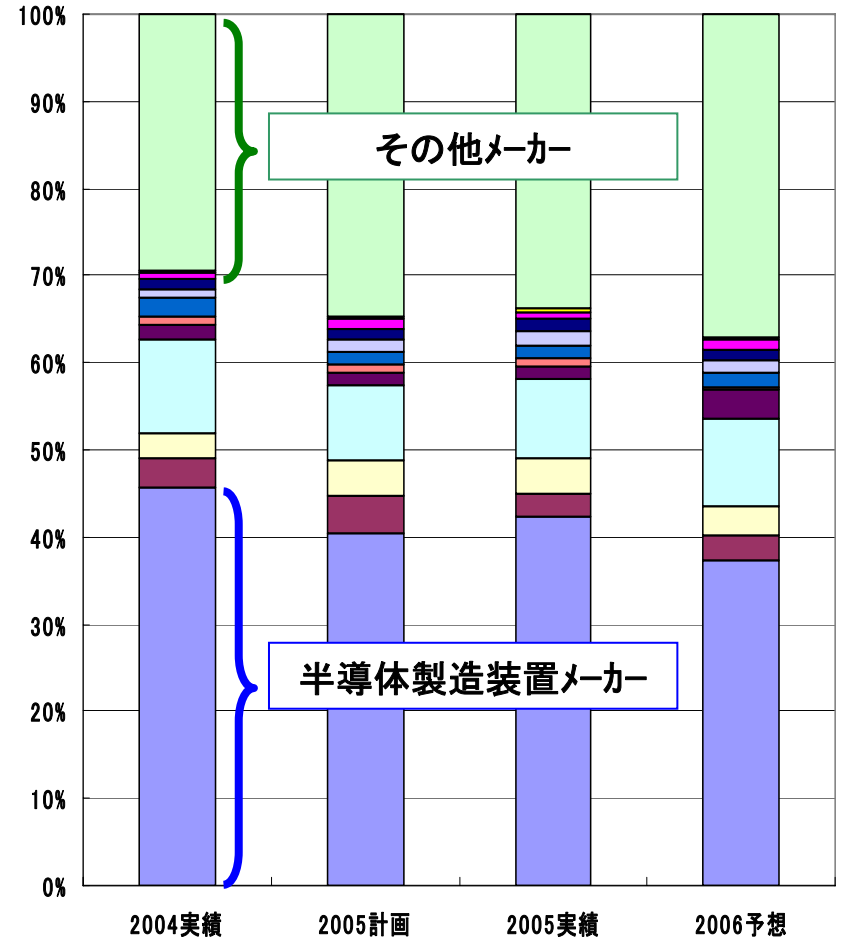


15. 個別 主要顧客先別売上

売上

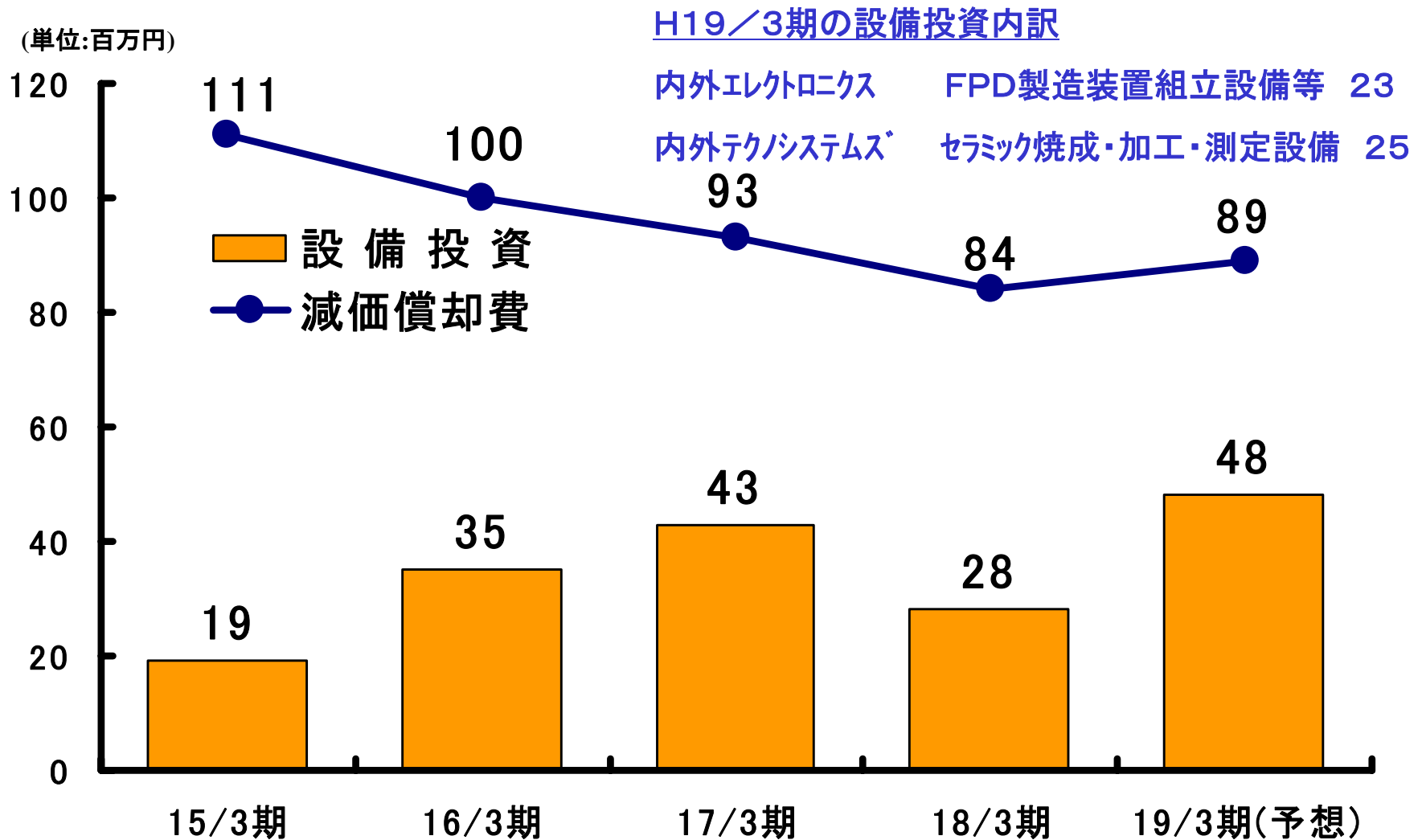


構成比



(本データは2006/3 決算前 速報値を基に作成しております)

16. 連結 設備投資・減価償却費の推移



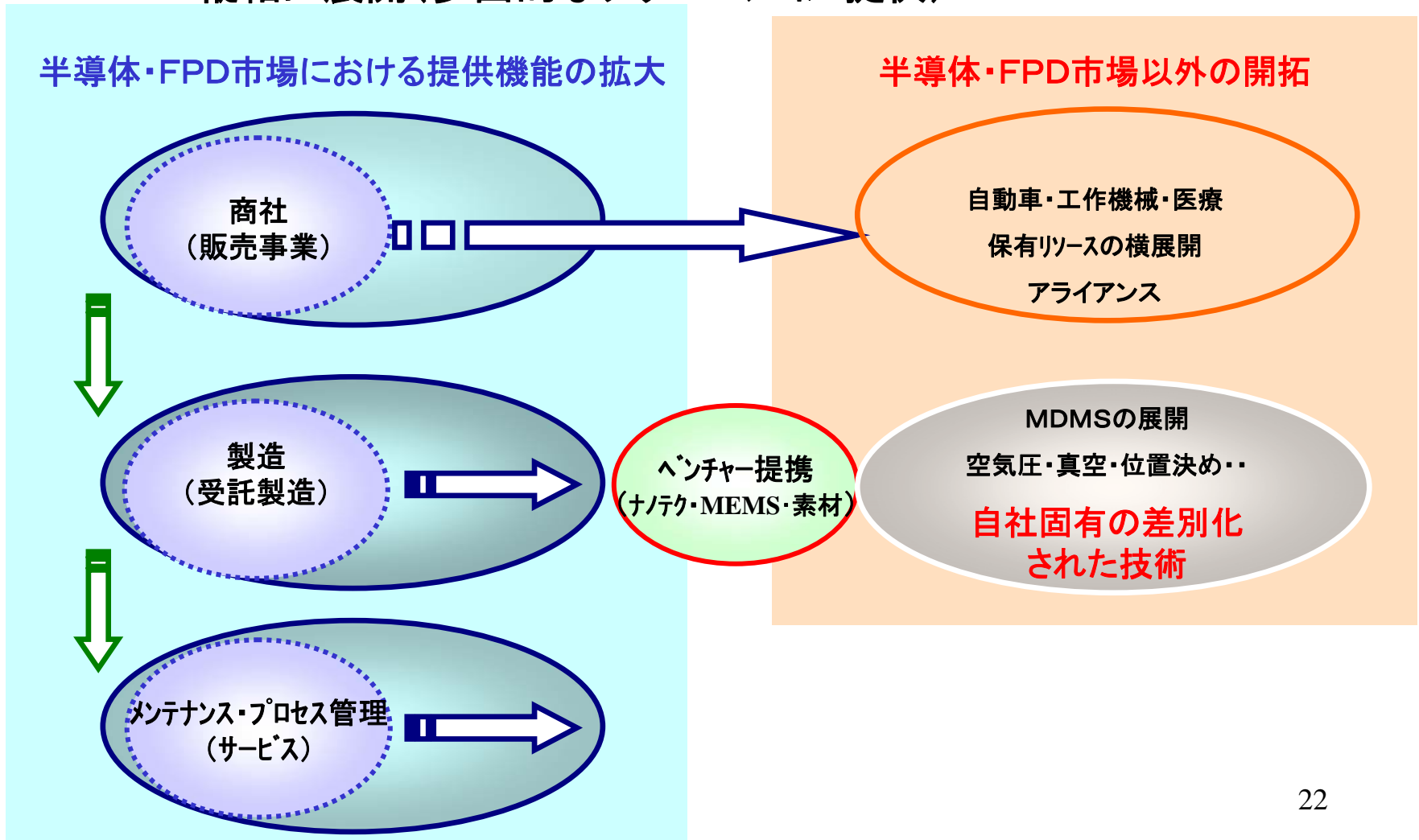
経営課題と事業の方向性

17. 事業戦略の再構築

1. 半導体市場に対する依存率を3年で70%までに下げる。
2. 受託製造セグメント(MDMS)を3年で50億円まで拡大。 (内外エレクトロニクス)
3. 独自技術による自社製品の開発。
(内外テクノシステムズ 2006/6/1設立予定)

18. 事業拡大の方向性

1. 横軸に拡大(技術的に関連した分野)
2. 縦軸に展開(多面的なソリューション提供)



19. MDMS

MDMS

Mechatronics Design & Manufacturing Services

装置メーカーの設計から製作・設置までの一貫した機能を受託する。

1. メカトロニクス系のモジュール・ユニット・完成品
2. 顧客工場の一部として機能提供(リアルタイムの顧客連携)
3. 完成品の設置・保守・メンテナンスを実施
4. 顧客の顧客(エンドユーザー)の装置管理を受託

20. 顧客メリット

MDMS

Mechatronics Design & Manufacturing Services

顧客メリット

1. リードタイム短縮 ジャスト・イン・タイム実現
2. 棚卸資産圧縮
3. 間接コスト削減(資材調達・製造間接・保守メンテ)
4. 所要変動吸収

資産回転率の向上 ・ 固定費の変動費化 ・ コストダウン

21. 課題

解決しなければならない課題

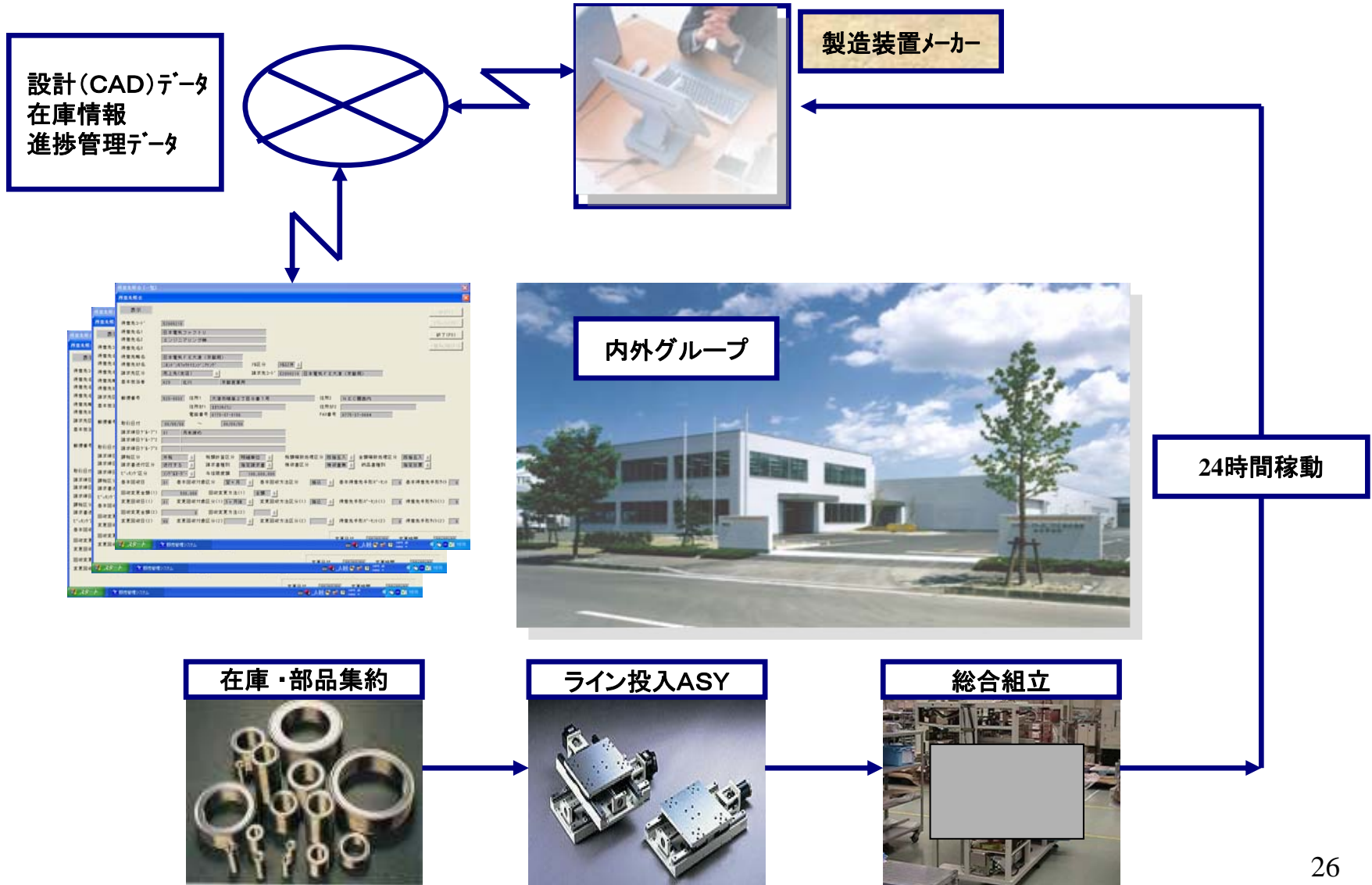
- ◎ 顧客のメリットは当社のリスクと同義語
- ◎ 単なるアセンブリでは外注と同レベル
設計機能によるVA/VE(これは最低必要条件)

顧客に存在しない、

当社固有の差別化された技術

がなければ成功しない

22. 顧客・仕入先工場の一部として機能



23. 自社製品の展開

大型多孔質セラミックス真空チャック

平成17年12月 株式会社ナノテムと業務提携

平成18年 6月 内外テクノシステムズ株式会社を設立(予定)

1. FPDの大型化に対応
2. 従来加工方法に比較し、製造コストの低減が可能
3. 半導体・FPD市場以外への商品展開可能



ファインテクノロジーで未来を拓く

NaigaiTEC

本日はありがとうございました。

- ・本資料は2007年3月期決算の予想及び今後の経営戦略等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。
- ・本資料に記載された意見、計画、予測等は、資料作成時点での当社の判断であり、その実現・達成を保証、約束するものではなく、また、その情報の正確性、完全性を保証、約束するものではありません。
- ・本資料に記載された内容は、予告なしに変更されることがあります。